



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100826003
2010 年 9 月 10 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP PBGAパッケージ 一部製品 モールド樹脂排出ピン位置変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施について通知のみを目的としたものになります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☒ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	ASP PBGA パッケージ 一部製品 モールド樹脂排出ピン位置変更 現行 : 排出ピン位置 サブストレート上 変更後: 排出ピン位置 モールド樹脂上			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	9 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) PBGAパッケージ 一部製品 モールド樹脂排出ピンの位置について、現行 サブストレート上を押して排出していますが、品質及び信頼性向上の為に、モールド樹脂上を押す排出に変更し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

モールド樹脂排出ピン位置

現行

サブストレート上

変更後

モールド樹脂上

理由：品質及び信頼性向上の為

対象製品リスト

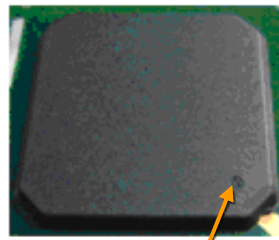
対象製品名				
D610A003BZDP225	TMS320C6424ZDU6	TMS320C6713BGDP225	TMS320F28335ZJZA	TMS32C6713BZDPA200
OMAP5910JZDY2	TMS320C6711BGFN150	TMS320C6713BGDP300	TMS320F28335ZJZS	TNETV2010AFNBGDS
TMS320C6211BGFN150	TMS320C6711DGBP200	TMS320C6713BZDP225	TMS320SP6713BGDP25	TNETV2010AFNBZDS
TMS320C6211BGFN167	TMS320C6711DZDP200	TMS320C6713BZDP300	TMS320SP6713GDP225	TNETV2010AZDS
TMS320C6211BZFN150	TMS320C6711DZDP250	TMS320DM6435ZDU5	TMS320TCI110ZPJ	TNETV2020AGDS
TMS320C6421ZDU4	TMS320C6711GFN150	TMS320DM6437ZDU6	TMS320TCI120AZDP	TNETV2020AZDS
TMS320C6424ZDU4	TMS320C6712DGBP150	TMS320DM6437ZDU7	TMS32C6711DGDPA167	TNETV2021AFNBZDS
TMS320C6424ZDU6	TMS320C6712DZDP150	TMS320F28234ZJZS	TMS32C6713BGDPA200	

製品表示

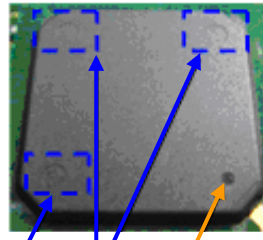
この変更に伴い、モールド樹脂上に若干のモールド樹脂排出痕が残ります。

モールド樹脂上 排出ピン痕なし

モールド樹脂上 排出ピン痕あり



Pin1 Indicator



排出ピン痕

Pin1 Indicator

図1 モールド樹脂排出痕

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2008 年 9 月 9 日	終了	2008 年 11 月 5 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	OMAP5948IZXFRQ1		-	-
Assembly Site:	TI-Philippines	Package/Code/Pins:	PBGA/ZXF/456	
Mount Compound:	Ablebond 2300	Mold Compound:	Sumitomo G770	
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	Substrate Vendor:	Kinsus	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Thermal Shock	-55/125C, 1000cyc		231/0	
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc		231/0	
Notes: **Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3/260C				